

姓名：谢春毅

求职意向： 硬件工程师

性别：男

籍贯：广西

工作经验：5~10 年

电话：18612031686

年龄：30

学历：全日制本科

邮箱：2271267280@qq.com

学校：黑龙江工程学院

专业：电子信息工程

工作经历

- 2017.7-2020.3

深圳中翼特种装备制造有限公司

硬件工程师

特殊行业

工作期间，协助负责基于北斗定位方案的无人机航空器落水定位设备装备的开发，在高级硬件工程师的指导下完成原理图设计，PCB Layout，BOM 表的整理输出工作

协助场外测试的数据收集整理

协助单板回板测试
- 2020.4~2023.4

深圳泽惠通有限公司

硬件工程师

通信行业

工作期间，主要协助完成基于数字基带核心板的硬件设计工作

1，协助完成数字基带核心板的硬件概要设计

2，协助完成基于 Intel SOC 平台方案和 FPGA 平台方案的数字基带核心板设计

3，负责硬件单板的回板信号测试，包括 DCDC 纹波，高低温，跌落等测试

4，协助负责单板转产问题的解决与单板转产问题的维护

负责 LTE/GSM 热点基站底板单元的硬件项目

1，负责基于 88E6085 平台的网络交换底板单元的硬件设计，外挂核心板 4 核心板通信控制功能，千兆以太网，USB WIFI，3G/4G Model，USB，GPS 模块等外设

2，负责原理图设计，DCDC 芯片选型

3，负责 PCB Layout

4，BOM 表的输出

5，转产单板的维护，整机功能的配合测试等工作
- 2023.5~2025.1

深圳创想三维科技有限公司

硬件工程师

FDM 3D 打印机行业

工作期间，负责消费级桌面型 3D 打印机低成本方案的上位机主板硬件设计，主要完成了基于全志平台的低成本 SOC 上位机控制板的设计，外挂 RGB 显示屏，百兆网口 PHY，CAN，RS485，DDR，UART，WIFI 模组等外设，完成如下内容

6，全志低成本方案平台的上位机 SOC 原理图设计

7，BOM 表的输出

8，PCB Layout

9，回板测试，整机 EMC 测试

10，转产生产产线跟线，解决生产问题

11，其余的一些问题处理
- 2025.1~2026.8

深圳市原子重塑科技有限公司

硬件工程师

FDM 3D 打印机行业

工作期间，负责消费级桌面打印机项目主控板和上位机主板的硬件设计，主要完成如下工作内容：

上位机 SOC 主控板的硬件设计与选型

- 1，设计了基于 RK 平台的硬件上位机控制板，采用 RK 高性价比芯片平台作为整个打印机的控制核心，外挂 MIPI 显示屏，EMMC 电路，DDR，高速 USB，WIFI 模组，网口 PHY，芯片和 DCDC 电源和 PMIC 供电芯片，完成了硬件器件的选型，硬件方案设计，硬件原理设计，组织硬件原理图评审，Layout 设计并指导 Layout 设计以及 Layout 评审工作，输出原理图评审修改文档和 Layout 设计修改文档
- 2，BOM 文件的制作输出
- 3，负责硬件样板的回板测试工作，独立完成单板的 DCDC 纹波，带载等硬件单板测试，拉动嵌入式软件工程师配合完成单板的功能测试与验证，输出自测试报告
- 4，配合整机功能完成单板转产任务并参与 EMC 测试认证与整改
- 5，产线跟线量产故障问题分析，并及时给出解决方案

下位机电机驱动板的硬件设计与选型

- 1：设计了基于 GD32 平台的电机驱动控制主板的硬件电路设计，外挂电机驱动电路，风扇控制电路，光电控制电路，霍尔磁铁编码电路的硬件设计，完成了硬件主控的 MCU 选型，电机驱动芯片的选型，以及电路设计，DCDC 等的电源电路设计工作
- 2：指导 Layout 设计以及组织 Layout 评审工作，并组织部门同事进行原理图评审和 Layout 评审
- 3：BOM 文档的制作
- 4：硬件单板的回板测试，电性能测试，电源和信号质量测试，拉动软件嵌入式工程师配合完成单板的功能验证，整理单板自测试报告
- 5：完成整机安装和单板转产任务，并参与整机 EMC 的测试与认证
- 6：产线跟新啊量产问题故障分析和给出解决方案

自我评价



熟练使用 Cadence Allegro，原理图和 PCB 设计工具

具有良好的模拟和数字电路基础知识

熟悉 EMC/EMI

能够阅读并理解的芯片 Datasheet

熟悉常用的 I2C，SPI，458,232 等通信协议

熟悉常用的高速通信接口信号的设计，PCIE，USB，MIPI，PHY 等

熟悉示波器等常用的调试工具